

工业和信息化部
2025 年第六批推荐性国家标准制修订计划
(征求意见稿)

工业和信息化部

二〇二五年六月

2025 年第六批推荐性国家标准制修订计划表

序号	项目编号	项目名称	性质	标准类别	制修订	代替标准	采标情况	项目周期(月)	部内主管司局	技术委员会或技术归口单位	主要起草单位	备注
1.	GSJCPZT0112-2025	可穿戴电子设备与技术 电子纺织品 导电纱线基本属性测量方法	推荐	方法	制定		IEC 63203 -201- 1:202 2, IDT	16	电子信息司	全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、小米科技有限责任公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、浙江大学、东南大学	
2.	GSJCPZT0113-2025	可穿戴电子设备与技术 电子纺织品 导电织物和绝缘材料基本性能测量方法	推荐	方法	制定		IEC 63203 -201- 2:202 2, IDT	16	电子信息司	全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、小米科技有限责任公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、浙江大学、东南大学	
3.	GSJCPZT0114-2025	可穿戴电子设备与技术 电子纺织品 洗涤耐久性评估测试方法	推荐	方法	制定		IEC 63203 -204- 1:202 3, IDT	16	电子信息司	全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、小米科技有限责任公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、浙江大学、东南大学	
4.	GSJCPZT0115-2025	可穿戴电子设备与技术 电子纺织品 在模拟微气候条件下导电纺织品电阻的测定	推荐	产品	制定		IEC 63203 -201- 3:202 1, IDT	16	电子信息司	全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、小米科技有限责任公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、浙江大学、东南大学	
5.	GSJCPZT0116-2025	半导体封装热标准化 第2-1 部分:用于稳态分析的 半导体封装三维热仿真模型 分立器件封装	推荐	基础	制定		IEC 63378 -2-1: 2024, IDT	12	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	山东华光光电子股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、深圳市美浦森半导体有限公司	
6.	GSJCPZT0117-2025	便携式产品锂离子电池充电管理芯片技术规范	推荐	方法	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、华为终端有限公司、芯源系统有限公司	

2025 年第六批推荐性国家标准制修订计划表

序号	项目编号	项目名称	性质	标准类别	制修订	代替标准	采标情况	项目周期(月)	部内主管司局	技术委员会或技术归口单位	主要起草单位	备注
7.	GSJCPZT0118-2025	集成电路电子设计自动化工具 光学临近校正(OPC)模型仿真软件建模输入数据结构	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	广东工业大学、中国电子技术标准化研究院、全芯智造技术有限公司、东方晶源微电子科技(北京)有限公司	
8.	GSJCPZT0119-2025	集成电路电子设计自动化工具 结构图形和网格交换格式	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	复旦大学、中国电子技术标准化研究院、北京智芯仿真科技有限公司、湖北九同方微电子有限公司	
9.	GSJCPZT0120-2025	集成电路电子设计自动化工具 晶圆级电性参数测试数据格式	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国科学院微电子研究所、杭州广立微电子股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、概伦电子股份有限公司	
10.	GSJCPZT0121-2025	集成电路电子设计自动化工具 数字波形应用程序接口	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	复旦大学、中国电子技术标准化研究院、宁波大学、浙江大学、芯华章科技股份有限公司	
11.	GSJCPZT0122-2025	汽车半导体器件电参数控制指南	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、复旦大学、杭州广立微电子股份有限公司、上海灵动微电子股份有限公司	
12.	GSJCPZT0123-2025	汽车集成电路电性能表征指南	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、清华大学、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司	
13.	GSJCPZT0124-2025	汽车芯片产品零缺陷指南	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、紫光同芯微电子有限公司	
14.	GSJCPZT0125-2025	汽车芯片良率统计结果分析指南	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、杭州广立微电子股份有限公司、中电科芯片技术(集团)有限公司、浙江大学滨江研	

2025 年第六批推荐性国家标准制修订计划表

序号	项目编号	项目名称	性质	标准类别	制修订	代替标准	采标情况	项目周期(月)	部内主管司局	技术委员会或技术归口单位	主要起草单位	备注
15.	GSJCPZT0126-2025	汽车用半导体光电器件应力试验要求	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国第一汽车股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团公司第四十四研究所	
16.	GSJCPZT0127-2025	汽车用铜引线互联器件可靠性试验要求	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、华东师范大学、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司	
17.	GSJCPZT0128-2025	汽车用微机电（MEMS）传感器应力试验要求	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	重庆长安汽车股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、华东师范大学、中国汽车工程研究院股份有限公司	
18.	GSJCPZT0129-2025	汽车用无铅器件可靠性试验要求	推荐	基础	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中国电子技术标准化研究院、清华大学、中国电子科技集团有限公司、华为技术有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司	
19.	GSJCPZT0130-2025	三维集成电路互连结构电迁移试验方法	推荐	方法	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	工业和信息化部电子第五研究所、中国电子技术标准化研究院、浙江清华柔性电子技术研究院	
20.	GSJCPZT0131-2025	三维集成电路内部缺陷无损检测方法	推荐	方法	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	工业和信息化部电子第五研究所、中国电子技术标准化研究院、浙江清华柔性电子技术研究院	
21.	GSJCPZT0132-2025	三维集成电路内部热特性测试方法	推荐	方法	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	工业和信息化部电子第五研究所、中国电子技术标准化研究院、浙江清华柔性电子技术研究院	
22.	GSJCPZT0133-2025	三维集成电路破坏性物理分析方法	推荐	方法	制定			18	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	工业和信息化部电子第五研究所、中国电子技术标准化研究院、浙江清华柔性电子技术研究院	
23.	GSJCPZT0134-2025	芯粒互联接口规范 第6部分：基于3D封装的物理层技术要求	推荐	基础	制定			16	电子信息司	全国集成电路标准化技术委员会	中关村高性能芯片互联技术联盟、清华大学、中国电子技术标准化研究院	